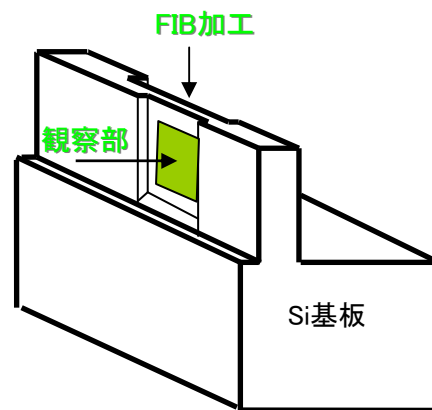




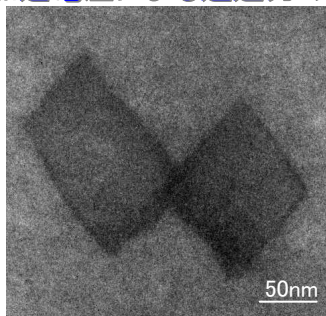
## 【1】FIBによる観察試料作製

- ・欠陥箇所を含む断面試料の作製
- ・厚さは1~3 μm (汎用TEM試料は0.2~0.5 μm以下)

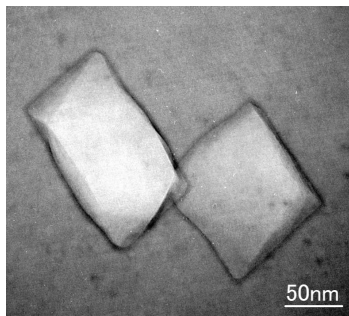
☆欠陥箇所の位置が高精度 (<0.3mm) で特定できない試料に有効



## 【2】加速電圧による透過力の違い



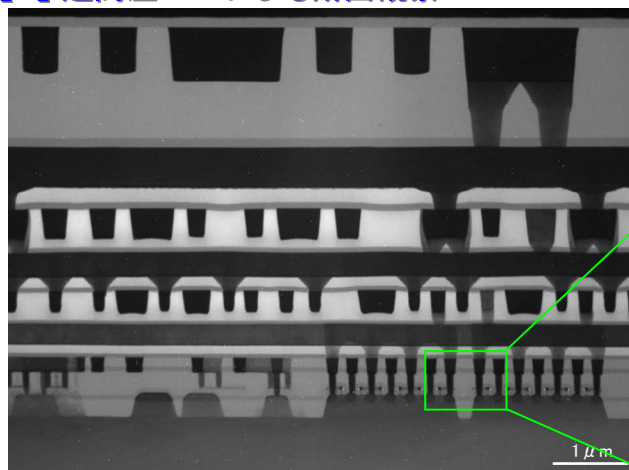
汎用TEM観察像 (Va=200kV)



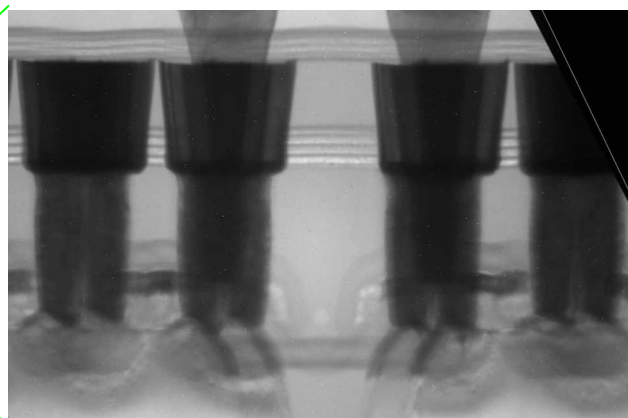
超高圧TEM観察像 (Va=2MV)

厚膜試料中におけるCOP欠陥の汎用TEMと超高圧TEMによる比較観察。  
(試料厚: 約1 μm、観察倍率: 100K倍)

## 【3】超高圧TEMによる断面観察

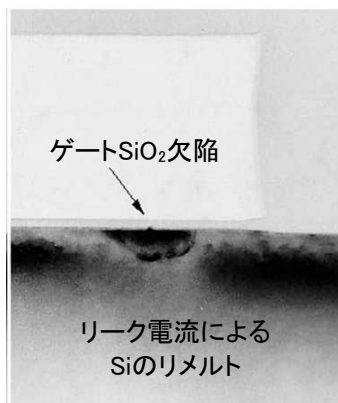


汎用TEMでは観察できない厚さの試料(1~3 μm)を観察することができ、内部の欠陥箇所を確実に見つけることができる。



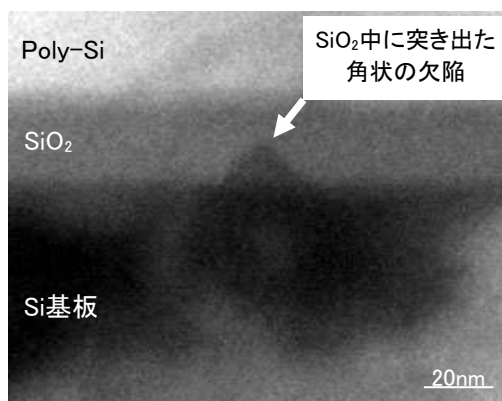
傾斜観察で立体的な観察が可能。

## 【4】欠陥部の拡大観察



超高圧TEM観察像 (Va=2MV)

厚い試料を作製してゲート発光部を観察。



薄膜化した後の欠陥中央部拡大TEM像 (Va=200kV)